

3A Avg.

30 Volts

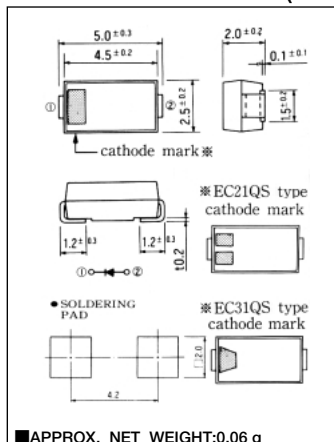
SBD

EC30HA03L

■最大定格 Maximum Ratings

Item	Symbol	Conditions	Unit
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	30	V
くり返しピークサージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V_{RSM}	35 パルス幅 $1\mu s$ 以下、デューティ 1/50 以下 Pulse Width $\leq 1\mu s$ Duty $\leq 1/50$	V
平均整流電流 Average Rectified Forward Current	I_O	50Hz、正弦半波通電抵抗負荷 50Hz Half Sine Wave Resistive Load	
		$T_a=25^\circ C^*$	1.89 A
		$T_l=102^\circ C$ Tl:lead Temperature	3.0 A
実効順電流 R.M.S. Forward Current	$I_F(RMS)$	4.71	A
サージ順電流 Surge Forward Current	I_{FSM}	60 50Hz正弦半波、1サイクル、非くり返し 50Hz Half Sine Wave, 1cycle, Non-repetitive	A
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}	$-40\sim+150$	$^\circ C$
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}	$-40\sim+150$	$^\circ C$

■OUTLINE DRAWING(mm)



■電氣的・熱的特性 Electrical/Thermal Characteristics

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I_{RM}	$T_j=25^\circ C, V_{RM}=V_{RRM}$	—	—	500	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V_{FM}	$T_j=25^\circ C, I_{FM}=3A$	—	—	0.54	V
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-a)}$	接合部・周囲間 Junction to Ambient	—	—	108	$^\circ C/W$
	$R_{th(j-l)}$	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	23	$^\circ C/W$

*プリント基板実装/Alumina Substrate Mounted (Soldering Land=2×2mm,Both Sides)

■定格・特性曲線

